

合肥颀中科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-014

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） 分析师会议 业绩说明会 路演/反路演活动 电话会议
来访单位名称	华泰证券、华商基金
时间	2025年12月23日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司最近上市的可转换公司债券募投项目的整体规划？</p> <p>答：在显示驱动芯片封测领域，公司计划通过“高脚数微尺寸凸块封装及测试项目”的落地实施，提升显示驱动芯片铜镍金凸块的产能规模，同步扩大CP、COG、COF环节的产能供给。此举将进一步完善公司在显示驱动芯片封测业务的整体布局与产品矩阵，从而巩固在显示驱动芯片封测领域——尤其是铜镍金细分领域的市场领先地位；在非显示类芯片封测领域，公司依托在凸块制造、晶圆减薄等工艺的深厚积累，积极布局“FSM（正面金属化）+BGBM（背面减薄与金属化）+Cu Clip（铜片夹扣键合）”的先进封装组合，建立载板覆晶封装（FC）制程，优化公司产品布局，拓宽功率芯片应用领域，本次募投项目的实施将有利于提升公司非显示类封测业务全制程服务能力，带动现有制程的业务拓展。</p> <p>2. 问：公司可转换公司债券募投项目的效益情况？</p> <p>答：公司对本次可转换公司债券的效益测算预计所有收入全部来源于产品销售收入，营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出。针对高脚数微尺寸凸块封装及测试项目，预计项目完全达产后每年将实现销售收入为3.6亿元；针对先进功率及倒装芯片封测技术改造项目，预计项目完全达产后每年将实现销售收入为3.5亿元。</p>

	<p>3. 问：公司显示业务的主要客户？</p> <p>答：公司显示业务的主要客户有奕斯伟、格科微、瑞鼎、集创北方、联咏、云英谷、OMNIVISION TOUCH AND DISPLAY、矽创电子、通锐微等。</p> <p>4. 问：公司非显示业务的主要客户？</p> <p>答：公司非显示业务的主要客户有南芯半导体、杰华特、纳芯微、矽力杰、思瑞浦、圣邦微、锐石创芯、昂瑞微、艾为电子、唯捷创芯等。</p> <p>5. 问：公司与客户的合作模式？</p> <p>答：公司销售环节均采用直销的模式，公司与多家业内知名 IC 设计公司建立了稳定合作关系。</p> <p>6. 问：公司的前几大股东？</p> <p>答：截至 2025 年 9 月 30 日，公司的前三大股东分别为合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 24 日